

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零一八年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2018年5月10日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一八年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一八年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 2.101 億美元，環比減少 3.1%，主要受季節性因素和兩間工廠年度維護的影響，但同比增長 14.7%。
- 毛利率 32.1%，環比下降 1.6 個百分點，同比上升 2.4 個百分點。
- 期內溢利 4,020 萬美元，環比下降 3.1%，同比上升 18.1%。
- 每股盈利 0.04 美元，環比持平，同比上升 0.01 美元。
- 淨資產收益率（年化）9.2%。

二零一八年第二季度指引

- 我們預計銷售收入環比增長 5% ~ 7%。
- 我們預計毛利率約為 32% ~ 33%。

二零一七年度股利派發

董事會建議派付截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股 0.31 港元。待股東於五月十日（周四）召開的股東週年大會上批准後，末期股息將於二零一八年六月十四日（周四）派付予於二零一八年五月二十三日（周三）名列本公司股東名冊的股東。

總裁致辭

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對第一季度的業績評論道：

“本公司繼續蓬勃發展。在過去的這一季度，有兩間工廠進行了年度維護，但我們的團隊成功將維護周期縮短了近一天。因此，公司實現了比預期更高的銷售收入和毛利。銷售收入達 2.101 億美元，環比略減少 3.1%，但同比增長 14.7%。毛利率 32.1%，環比下降 1.6 個百分點，主要因季節性因素及折舊成本有所增加；但同比上升 2.4 個百分點，主要受益於晶圓銷售量增加、平均銷售價格提升及產能利用率提高。淨利潤率保持在 19.1%。銷售收入和毛利率均再一次超過預期。”

王煜先生繼續說道，“我們對公司持續增長的潛力充滿信心，同時正全力推進在無錫建成我們第一座 300mm（12 英寸）晶圓廠。近期來看，我們預計第二季度將會出現強勁增長，並又會是一個業績出色的季度。各產品領域的客戶需求均很強勁，尤其是銀行卡晶片和分立器件。我們很有信心今年再創佳績。”

電話會議公告

日期： 二零一八年五月十一日

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）
上午 04:00（紐約，2018 年 5 月 11 日）

發言人： 王煜，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2018_q1_earnings_call

電話詳細：

國際	+65 6713 5521
中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
香港	+852 3018 6768
臺灣	+886 277 031 751
紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 5568226

密碼： HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重復收聽會議。

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬+電源管理和邏輯+射頻等差異化工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。華虹半導體是華虹集團的一員，而華虹集團是國家“909”工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

華虹半導體在上海金橋和張江建有三座 200mm 晶圓廠（華虹一廠、二廠、及三廠），月產能約 17 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內在建一條月產能 4 萬片的 300mm 集成電路生產線（華虹七廠）。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
銷售收入	210,093	216,916	183,236	(3.1)%	14.7 %
銷售成本	(142,708)	(143,809)	(128,801)	(0.8)%	10.8 %
毛利	67,385	73,107	54,435	(7.8)%	23.8 %
毛利率	32.1 %	33.7 %	29.7 %	(1.6)	2.4
經營開支	(25,447)	(36,773)	(22,425)	(30.8)%	13.5 %
其他(損失)/收入淨額	(2,025)	12,200	2,403	(116.6)%	(184.3)%
稅前溢利	39,913	48,534	34,413	(17.8)%	16.0 %
所得稅收益/(開支)	318	(7,032)	(347)	(104.5)%	(191.6)%
期內溢利	40,231	41,502	34,066	(3.1)%	18.1 %
淨利潤率	19.1 %	19.1 %	18.6 %	-	0.5
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	40,097	41,502	34,066	(3.4)%	17.7 %
非控股權益	134	-	-	-	-
每股盈利					
基本	0.04	0.04	0.03	-	33.3 %
攤薄	0.04	0.04	0.03	-	33.3 %
付運晶圓(仟片)	454	501	432	(9.4)%	5.1 %
產能利用率 ¹	97.3 %	96.8 %	96.2 %	0.5	1.1
淨資產收益率 ²	9.2 %	10.0 %	9.2 %	(0.8)	-

二零一八年第一季度

- 銷售收入 2.101 億美元，環比減少 3.1%，主要受季節性因素和兩間工廠年度維護的影響，但同比增長 14.7%。
- 銷售成本 1.427 億美元，環比下降 0.8%，主要由於晶圓銷售量下降，部分被折舊成本增加所抵消；同比上升 10.8%，主要由於晶圓銷售量上升及折舊成本增加。
- 毛利率 32.1%，環比下降 1.6 個百分點，主要由於折舊成本增加；同比上升 2.4 個百分點，主要得益於晶圓銷售量上升、平均銷售價格提升及產能利用率提高，部分被折舊成本增加所抵消。
- 經營開支 2,540 萬美元，環比下降 30.8%，主要由於在上季度計提了年終獎金及設備減值準備；同比上升 13.5%，主要由於人工費用和研發開支增加。
- 其他損失淨額 200 萬美元，與上季度的其他收入淨額 1,220 萬美元相比，主要由於(i)分佔一家聯營公司溢利減少，及(ii)匯兌損失增加；與上年同期的其他收入淨額 240 萬美元相比，主要由於匯兌損失增加，部分被利息收入增加所抵消。
- 所得稅收益 30 萬美元，與上季度所得稅開支 700 萬美元相比，主要由於轉回上年計提的股利代扣代繳稅金 930 萬美元。
- 期內溢利 4,020 萬美元，環比下降 3.1%，但同比上升 18.1%。
- 淨利潤率 19.1%，環比持平，同比上升 0.5 個百分點。
- 每股盈利 0.04 美元，環比持平，同比上升 0.01 美元。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一八年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第一季度 % (未經審核)	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
晶圓	206,042	98.1 %	212,552	98.0 %	(6,510)	(3.1)%
其他	4,051	1.9 %	4,364	2.0 %	(313)	(7.2)%
銷售收入總額	210,093	100.0 %	216,916	100.0 %	(6,823)	(3.1)%

- 本季度 98.1% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一八年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第一季度 % (未經審核)	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
中國 ³	117,355	55.8 %	122,410	56.3 %	(5,055)	(4.1)%
美國	40,247	19.2 %	41,133	19.0 %	(886)	(2.2)%
亞洲 ⁴	23,937	11.4 %	22,246	10.3 %	1,691	7.6 %
歐洲	16,433	7.8 %	15,581	7.2 %	852	5.5 %
日本 ⁵	12,121	5.8 %	15,546	7.2 %	(3,425)	(22.0)%
銷售收入總額	210,093	100.0 %	216,916	100.0 %	(6,823)	(3.1)%

- 本季度來自中國的銷售收入 1.174 億美元，占銷售收入總額的 55.8%，環比減少 4.1%，主要由於智能卡芯片和模擬產品的需求減少。
- 本季度來自美國的銷售收入 4,020 萬美元，環比減少 2.2%，主要由於閃存和超級結產品的需求減少，部分被邏輯產品的需求增加所抵消。
- 本季度來自亞洲的銷售收入 2,390 萬美元，環比增加 7.6%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,640 萬美元，環比增加 5.5%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自日本的銷售收入 1,210 萬美元，環比減少 22.0%，主要由於 MCU、閃存、超級結和邏輯產品的需求減少。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一八年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第一季度 % (未經審核)	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
嵌入式非易失性存儲器	83,716	39.7 %	85,940	39.6 %	(2,224)	(2.6)%
分立器件	66,199	31.5 %	62,319	28.7 %	3,880	6.2 %
模擬與電源管理	35,409	16.9 %	40,572	18.7 %	(5,163)	(12.7)%
邏輯及射頻	19,227	9.2 %	19,200	8.9 %	27	0.1 %
獨立非易失性存儲器	5,385	2.6 %	8,327	3.8 %	(2,942)	(35.3)%
其他	157	0.1 %	558	0.3 %	(401)	(71.9)%
銷售收入總額	210,093	100.0 %	216,916	100.0 %	(6,823)	(3.1)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 8,370 萬美元，環比減少 2.6%，主要由於智能卡芯片的產品需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 6,620 萬美元，環比增長 6.2%，主要得益於通用 MOSFET 及 IGBT 產品的需求增加，部分被超級結產品的需求減少所抵消。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,540 萬美元，環比減少 12.7%，主要由於模擬和 LED 照明產品的需求減少。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 540 萬美元，環比減少 35.3%，主要由於閃存產品需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一八年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第一季度 % (未經審核)	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
0.13μm 及以下	70,249	33.4 %	76,054	35.1 %	(5,805)	(7.6)%
0.15μm 及 0.18μm	28,618	13.6 %	33,187	15.3 %	(4,569)	(13.8)%
0.25μm	4,650	2.2 %	4,769	2.2 %	(119)	(2.5)%
0.35μm 及以上	106,576	50.8 %	102,906	47.4 %	3,670	3.6 %
銷售收入總額	210,093	100.0 %	216,916	100.0 %	(6,823)	(3.1)%

- 本季度 0.13μm 及以下工藝技術節點的銷售收入 7,020 萬美元，環比減少 7.6%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 2,860 萬美元，環比減少 13.8%，主要由於模擬和閃存產品的需求減少。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.066 億美元，環比增長 3.6%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一八年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第一季度 % (未經審核)	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
電子消費品	142,645	67.9 %	151,242	69.7 %	(8,597)	(5.7)%
工業及汽車	36,709	17.5 %	28,115	13.0 %	8,594	30.6 %
通訊	21,051	10.0 %	27,358	12.6 %	(6,307)	(23.1)%
計算機	9,688	4.6 %	10,201	4.7 %	(513)	(5.0)%
銷售收入總額	210,093	100.0 %	216,916	100.0 %	(6,823)	(3.1)%

- 本季度電子消費品仍然是我們第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.426 億美元，占銷售收入總額的 67.9%，環比減少 5.7%，主要由於 MCU 和模擬產品的需求減少。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 3,670 萬美元，環比增長 30.6%，主要得益於 MCU 和 IGBT 產品需求的增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,110 萬美元，環比減少 23.1%，主要由於智能卡芯片和其他電源管理產品的需求減少。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	63	63	56
2 號晶圓廠	57	57	57
3 號晶圓廠	48	48	42
合計	168	168	155
產能利用率	97.3%	96.8%	96.2%

- 本季度產能利用率 97.3%，上季度為 96.8%。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
付運晶圓	454	501	432	(9.4)%	5.1 %

- 本季度付運晶圓 454,000 片，環比減少 9.4%，主要由於季節性因素及兩間晶圓廠年度維護的影響。

經營開支分析

以千美元計	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
銷售及分銷費用	1,749	2,153	1,500	(18.8)%	16.6 %
管理費用 ⁷	23,698	34,620	20,925	(31.5)%	13.3 %
經營開支	25,447	36,773	22,425	(30.8)%	13.5 %

- 經營開支 2,540 萬美元，環比下降 30.8%，主要由於在上季度計提了年終獎金及設備減值準備；同比上升 13.5%，主要由於人工費用和研發開支增加。

其他(損失)/收入淨額

以千美元計	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
租金收入	3,419	3,362	3,049	1.7 %	12.1 %
利息收入	2,720	2,042	1,445	33.2 %	88.2 %
匯兌損失	(8,823)	(2,992)	(1,353)	194.9 %	552.1%
分佔一家聯營公司溢利/(損失)	453	8,515	(298)	(94.7)%	(252.0)%
財務費用	(594)	(572)	(515)	3.8 %	15.3 %
政府補貼	420	2,519	384	(83.3)%	9.4 %
其他	380	(674)	(309)	(156.4)%	(223.0)%
其他收入淨額	(2,025)	12,200	2,403	(116.6)%	(184.3)%

- 其他損失淨額 200 萬美元，與上季度的其他收入淨額 1,220 萬美元相比，主要由於(i)分佔一家聯營公司溢利減少，及(ii)匯兌損失增加；與上年同期的其他收入淨額 240 萬美元相比，主要由於匯兌損失增加，部分被利息收入增加所抵消。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
經營活動所得現金流量淨額	57,542	88,282	30,049	(34.8)%	91.5 %
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(12,281)	38,653	(44,456)	(131.8)%	(72.4)%
融資活動所得/(用)現金流量淨額	189,645	208	(512)	91,075.5 %	(37,140.0)%
外匯匯率變動影響淨額	7,865	3,894	1,452	102.0%	441.7 %
現金及現金等價物變動影響淨額	242,771	131,037	(13,467)	85.3 %	(1,902.7)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 5,750 萬美元，環比下降 34.8%，主要由於(i)貿易付款增加，(ii)支付年終獎金，部分被從一家關聯公司收到房租款所抵消。
- 本季度投資活動所用現金流量淨額 1,230 萬美元，其中包括設備投資支出 8,670 萬美元，被(i)收回定期存款投資 7,180 萬美元，及(ii)收到利息收入 260 萬美元所抵消。
- 本季度融資活動所得現金流量淨額 1.896 億美元，其中包括(i)控股子公司華虹半導體（無錫）有限公司收到資本金 1.880 億美元，(ii)因股票期權行權而增發股份收到的投資款 210 萬美元，部分被支付利息 50 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)
資產總額	2,375,277	2,078,306
負債總額	381,954	383,101
所有者權益總額	1,993,323	1,695,205
資產負債率 ⁸	16.1%	18.4%

資本開支

以千美元計	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)
華虹宏力	36,894	17,780
華虹無錫	49,797	-
合計	86,691	17,780

- 本季度資本開支 8,670 萬美元，其中 4,980 萬美元用於華虹無錫。

⁸資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)
存貨	128,255	115,578
貿易應收款項及應收票據	125,639	112,372
預付款項、按金及其他應收款項	11,163	10,074
應收關聯方款項	52,052	46,988
已凍結存款及定期存款	125,236	193,530
現金及現金等價物	617,661	374,890
流動資產總額	1,060,006	853,432
貿易應付款項	69,037	68,124
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	110,505	129,908
計息銀行借款	60,931	60,751
政府補助	44,410	40,523
應付關聯方款項	22,143	10,885
應付所得稅	33,660	26,648
流動負債總額	340,686	336,839
淨營運資金	719,320	516,593
速動比率	2.7x	2.2x
流動比率	3.1x	2.5x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	57	52
存貨周轉天數	77	72

- 存貨由上季度末的 1.156 億美元上升至本季度末的 1.283 億美元，主要由於客戶的晶圓需求增加。
- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 1.124 億美元上升至本季度末的 1.256 億美元，主要由於若干客戶的銷售收入增加。
- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1,010 萬美元上升至本季度末的 1,120 萬美元，主要由於對供應商的預付款增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 4,700 萬美元上升至本季度末的 5,210 萬美元，主要由於來自一家關聯方的貿易應收款項及應收票據增加。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 1.935 億美元下降至本季度末的 1.252 億美元，主要由於收回定期存款投資。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 1.299 億美元下降至本季度末的 1.105 億美元，主要由於支付年終獎金。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,090 萬美元上升至本季度末的 2,210 萬美元，主要由於收到關聯方的預付租金款。
- 應付所得稅由上季度末的 2,660 萬美元上升至本季度末的 3,370 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支。
- 本季度末淨營運資金 7.193 億美元，流動比率 3.1。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 57 天。
- 本季度存貨周轉天數為 77 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)
銷售收入	210,093	216,916	183,236
銷售成本	(142,708)	(143,809)	(128,801)
毛利	67,385	73,107	54,435
其他收入及收益	6,647	7,160	5,081
投資物業的公平值收益	-	89	-
銷售及分銷費用	(1,749)	(2,153)	(1,500)
管理費用	(23,698)	(34,620)	(20,925)
其他費用	(8,531)	(2,992)	(1,865)
財務費用	(594)	(572)	(515)
分佔一家聯營公司溢利/(損失)	453	8,515	(298)
稅前溢利	39,913	48,534	34,413
所得稅收益/(開支)	318	(7,032)	(347)
期內溢利	40,231	41,502	34,066
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	40,097	41,502	34,066
非控股權益	134	-	-
持有人應佔每股盈利			
基本	0.04	0.04	0.03
攤薄	0.04	0.04	0.03
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,039,145,939	1,036,020,104	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,051,206,939	1,047,910,104	1,041,332,656

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一七年 (已審核)	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	752,938	733,462	678,861
投資物業	186,614	179,586	169,997
預付土地租賃款項	21,267	20,634	20,021
無形資產	7,380	7,411	8,226
於聯營公司的投資	60,285	57,577	45,070
可供出售投資	224,313	215,864	204,441
長期預付款項	55,005	3,266	4,065
遞延稅項資產	7,469	7,074	6,078
非流動資產總額	1,315,271	1,224,874	1,136,759
流動資產			
存貨	128,255	115,578	96,038
貿易應收款項及應收票據	125,639	112,372	109,026
預付款項、按金及其他應收款項	11,163	10,074	13,960
應收關聯方款項	52,052	46,988	53,625
已凍結存款及定期存款	125,236	193,530	130,341
現金及現金等價物	617,661	374,890	327,788
流動資產總額	1,060,006	853,432	730,778
流動負債			
貿易應付款項	69,037	68,124	62,172
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	110,505	129,908	98,913
計息銀行借款	60,931	60,751	1,884
政府補助	44,410	40,523	38,176
應付關聯方款項	22,143	10,885	9,455
應付所得稅	33,660	26,648	30,269
流動負債總額	340,686	336,839	240,869
流動資產淨額	719,320	516,593	489,909
總資產減流動負債	2,034,591	1,741,467	1,626,668
非流動負債			
計息銀行借款	33,396	32,139	90,946
遞延稅項負債	7,872	14,123	3,990
非流動負債總額	41,268	46,262	94,936
淨資產	1,993,323	1,695,205	1,531,732
權益和負債權益			
股本	1,557,264	1,554,870	1,550,164
儲備	246,891	140,335	(18,432)
本公司擁有人應佔權益	1,804,155	1,695,205	1,531,732
非控股權益	189,168	-	-
權益總額	1,993,323	1,695,205	1,531,732

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日	於十二月三十一日	於三月三十一日
	二零一八年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)
經營活動所得現金流量:			
稅前溢利	39,913	48,534	34,413
折舊及攤銷	30,178	28,217	23,541
應佔聯營公司(溢利)/損失	(453)	(8,515)	298
營運資金的變動及其它	(12,096)	20,046	(28,203)
經營活動所得現金流量淨額	57,542	88,282	30,049
投資活動所(用)/得現金流量:			
購買物業、廠房及設備項目	(86,691)	(17,780)	(40,942)
其他投資活動所得/(用)現金流量	74,410	56,433	(3,514)
投資活動所(用)/得現金流量	(12,281)	38,653	(44,456)
融資活動所得/(用)現金流量:			
非控股權益資本注資	188,000	-	-
發行股份所得收益	2,186	2,759	-
償還銀行貸款	-	(1,990)	-
已付利息	(541)	(561)	(512)
融資活動所得/(用)現金流量	189,645	208	(512)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	234,906	127,143	(14,919)
外匯匯率變動影響淨額	7,865	3,894	1,452
期初現金及現金等價物	374,890	243,853	341,255
期末現金及現金等價物	617,661	374,890	327,788

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一八年五月十日